

# 「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」 ～Society5.0 世界における未来のスマートシティの実現に貢献する 電子部品の動向～

## 発刊および報告会のご案内

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)電子部品部会／部品技術ロードマップ専門委員会では、2022 年発刊の「電子部品技術ロードマップ」を改訂し、「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」を発刊いたしました。

本ロードマップでは、Society 5.0 の実現を見据え、2035 年までの電子部品技術の進展を展望するものとして編纂し、特に、未来のスマートシティを社会変化の象徴として捉え、「モビリティ」「情報通信」「環境」の 3 つの注目フィールドに焦点を当て、それぞれの技術動向を詳細に解説しています。

さらに、近年急速に進化する生成 AI 技術が電子部品業界に与える影響についても、新たに「生成 AI のインパクト」として独立した章を設けています。

第 11 版では、読者の利便性向上を図るため、従来より要望の多かった電子化対応を実施し、PDF ファイルのダウンロード版として頒布することといたしました。

また、読者アンケートで要望のあったエグゼクティブサマリーを「注目フィールド」および「生成 AI のインパクト」に追加し、より理解しやすい構成となるよう工夫しております。加えて、電子部品技術と社会実装される技術群との関連性を明確にするため関連表を作成し、読者の方のガイドとなるようにしています。

第 11 版は、多くの専門家、企業関係者、大学研究者のご協力を得て、多角的な視点から将来の社会変化と電子部品技術の展望を描きました。

また、「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」発刊に伴い、本冊子の内容をより深めていただくことを目的として、ご購入いただいた方を対象に、報告会を開催いたします。(詳細は次ページ)

関係各所等に広く周知いただき、多くの皆様のご参加を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

- 刊行物 : 「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」
- 編集・発行 : 一般社団法人 電子情報技術産業協会  
電子部品部会・部品技術ロードマップ専門委員会

- 体裁 : A4 判 PDF 形式  
3 つのファイルにて上巻・中巻・下巻で構成  
上巻: 第 1 章、第 2 章 (約 480 ページ・75MB)  
中巻: 第 3 章 (約 350 ページ・43MB)  
下巻: 第 4 章、第 5 章 (約 330 ページ・33MB)

- 頒布価格 : 28,000 円 (会員)  
56,000 円 (会員外)

- 購入サイト : <https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=924&cateid=4>



## 「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」完成報告会のご案内

「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」発刊に伴い、本冊子の内容をより深くご理解いただくことを目的として、ご購入者様を対象に、下記の通り報告会を開催いたします。

本報告会では、本報告書の概要紹介に加え、特別講演として、(株) Preferred Networks の共同創業者であり、代表取締役 研究最高責任者として最先端技術の開発を先導されている岡野原 大輔 氏をお迎えし、「AI と半導体の未来:可能性と克服すべき課題」をテーマにご講演いただきます。

- 日 時 : 2025 年 3 月 28 日(金)10:00~17:00
- 会 場 : 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)  
※オンラインとの併用開催  
会場での参加者定員:50 名程度(先着順)

※会場には、全員分の電源をご利用いただける環境はございません。  
そのため、会場参加の方には投影資料を紙で配布いたします。  
(ただし、特別講演の資料は配布いたしません。)

※「会場参加」でお申し込みいただいた方には、当日、昼食(お弁当)をご用意します。

- プログラム : 次ページに記載
- 申込方法 : 「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」をご購入いただいた方のみ  
ご参加頂けます。  
(参加費無料)  
■購入サイト:  
<https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=924&cateid=4>

===【参加方法】===

ご購入頂きました方に送付される「購入申込メール」内に申込方法の記載  
がございます。

=====

- 申込期限 : 2025 年 3 月 25 日(火)  
※会場の収容人数に達し次第、「会場参加」の受付を終了いたします。  
(「オンライン参加」には、人数の上限はございません。)
- 問合せ先 : 一般社団法人 電子情報技術産業協会  
事業推進部(三武)  
E-mail:[eep1@jeita.or.jp](mailto:eep1@jeita.or.jp)

## <「第 11 版 電子部品技術ロードマップ」完成報告会 プログラム>

<b>第 1 部：全体概略・未来のスマートシティー</b>		
10:00～ 10:10	●全体概略	部品技術ロードマップ専門委員会 主査 加藤 喜文 アルプスアルパイン(株)
<b>第 2 部：注目フィールド①</b>		
10:10～ 12:00	●スマートシティー ●モビリティー ●情報通信	松尾 豊 (株)村田製作所 高崎 哲也 KOA(株) 夏目 真志 太陽誘電(株)
休憩(昼食)		
<b>第 3 部：特別講演①</b>		
13:00～ 14:00	●「AI と半導体の未来:可能性と克服すべき課題」 (株) Preferred Networks 代表取締役 研究最高責任者 岡野原 大輔 氏	
<b>第 4 部：生成 AI のインパクト</b>		
14:00～ 14:30	●生成 AI のインパクト	寶藏寺 学 太陽誘電(株)
<b>第 5 部：特別講演②</b>		
14:30～ 14:40	●「コンピューティングの市場・技術トレンド」 保坂 透 氏 Yole(株)	
<b>第 6 部：注目フィールド②</b>		
14:40～ 15:10	●環境	宮田 祐一 双信電機(株)
<b>第 7 部：電子部品技術の動向</b>		
15:20～ 16:50	●インダクター・通信モジュール ●コンデンサー・EMC 部品 ●抵抗器 ●コネクタ ●入出力デバイス・アクチュエーター ●センサー ●電子部品材料	夏目 真志 太陽誘電(株) 松尾 豊 (株)村田製作所 高崎 哲也 KOA(株) 石川 哲弥 日本航空電子工業(株) 加藤 喜文 アルプスアルパイン(株) 工藤 千秋 パナソニック インダストリー(株) 松木 謙典 JFE ミネラル(株)
<b>閉会</b>		
16:50～ 17:00	●閉会挨拶	工藤 千秋 パナソニック インダストリー(株)

※プログラム、発表者、時間については、事前の予告なく変更する場合があります。

あらかじめご了承ください。

※進行状況により、各プログラムの時間が前後する可能性があります。オンラインで途中から入室される方は、余裕をもってご参加ください。